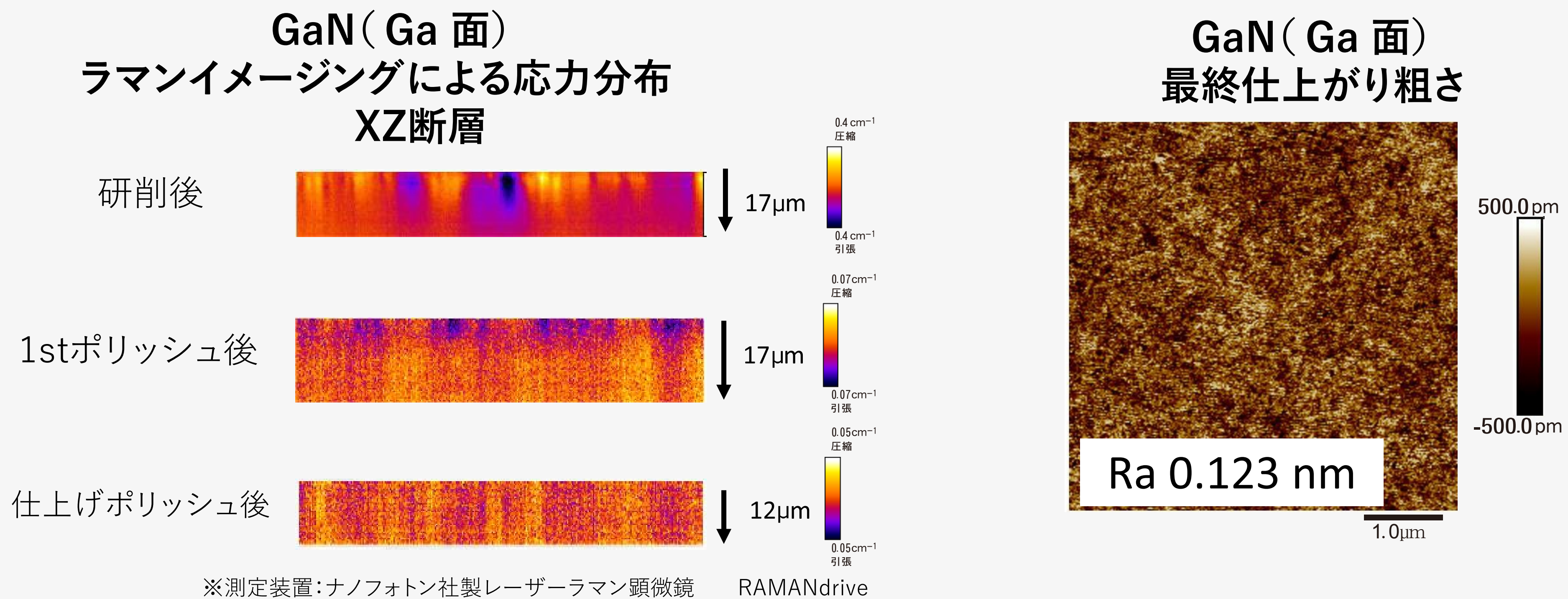
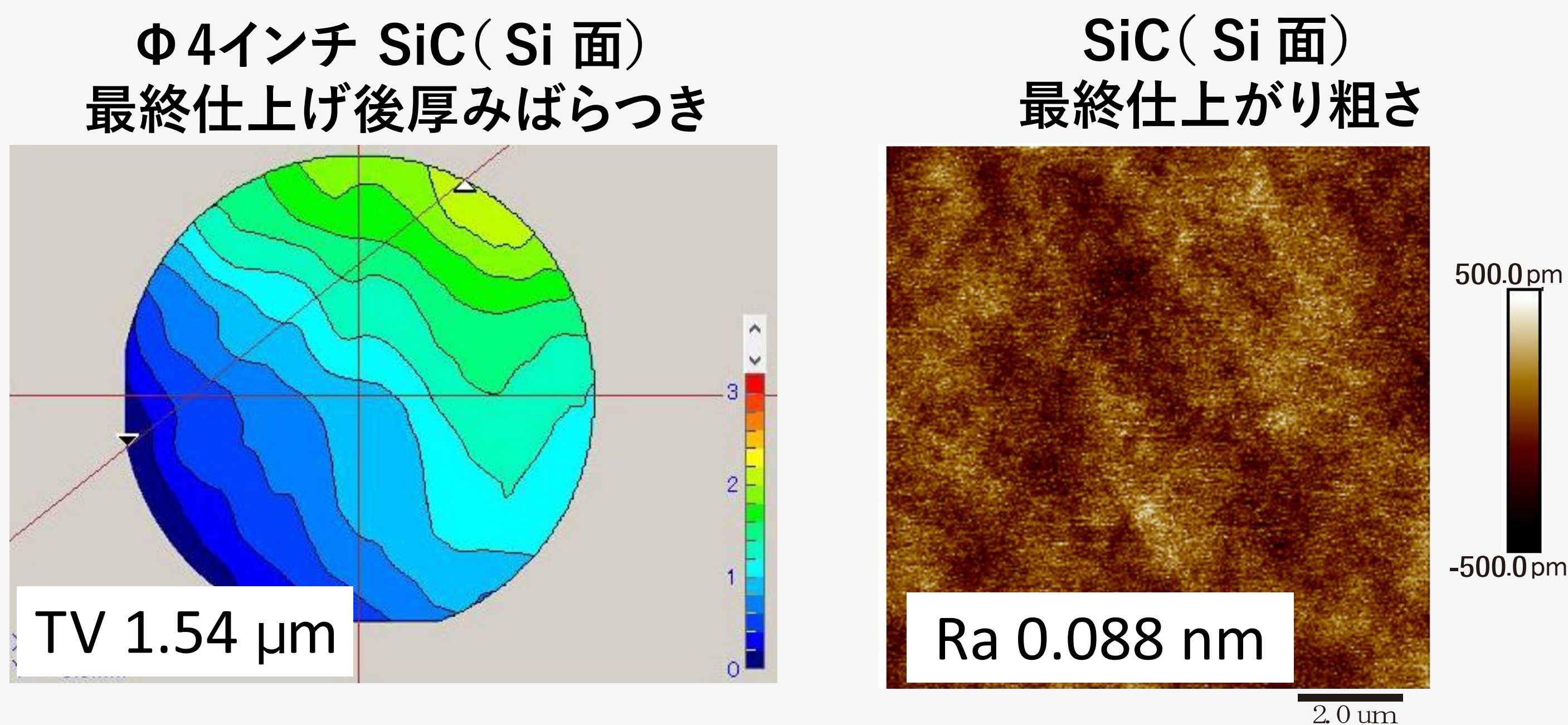


次世代パワー半導体の平坦化研磨技術

GaN・AlN



SiC

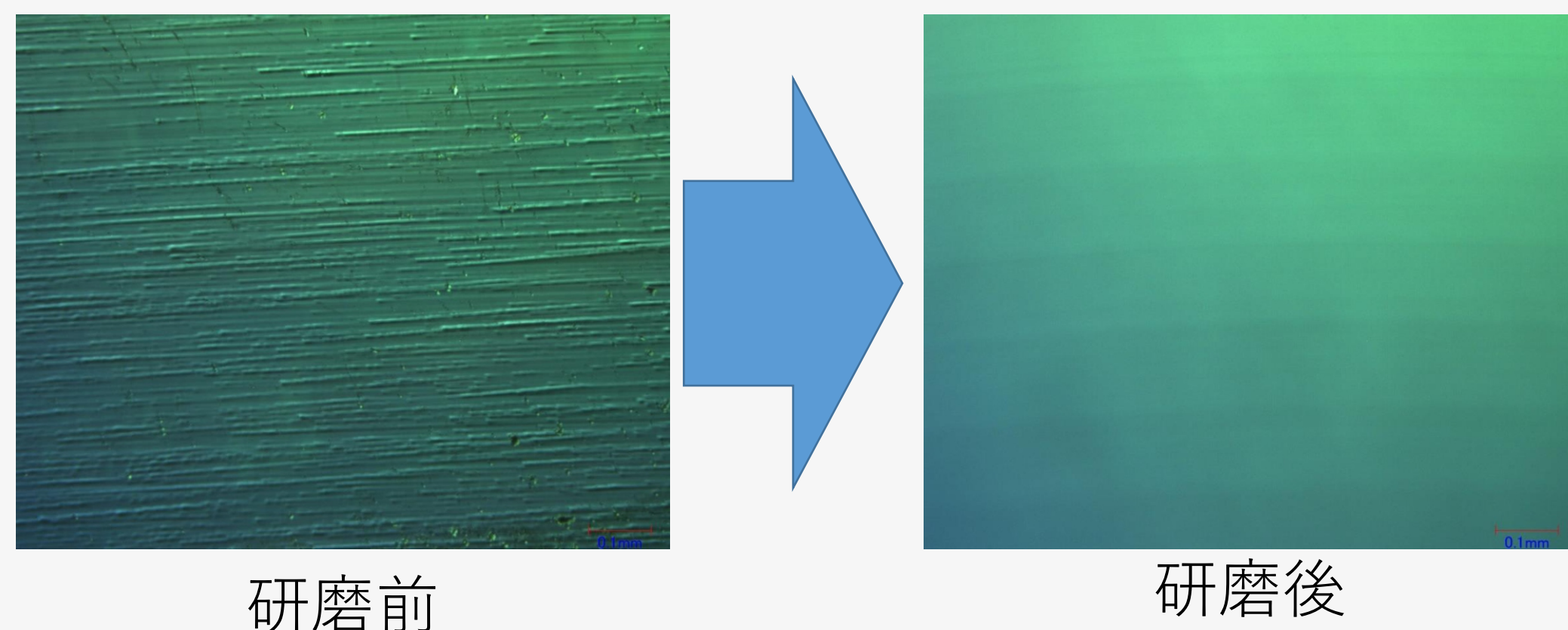


エピ付き基板、

HPSI基板の加工も行っております。

Diamond

粗さ低減の研磨を得意としております。



3×3 mmの小片基板から**φ150 mm**

まで対応可能です。

非極性面の加工も行っております。

